

## 第一节 重要提示

本公司年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

本公司已在报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.公司上市未满三年且尚未转增股本

7.董事在表决通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

综合考虑各方面经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素,为更好传递公司对后续发展的坚定信心,更向同中小投资者,在充分考虑公司日常经营及发展规划资金需求的前提下,公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.86元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本80,629,354股,以此计算拟派发现金红利1500万元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

本公司利润分配预案尚需经股东大会审议。

8.是否存有公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二章 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简称

广州方邦

V适用 □不适用

公司股票简称	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
广州方邦电子科技股份有限公司	上海证券交易所科创板	方邦股份	688020	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人及联系方式

联系人姓名	董事会秘书(信息披露负责人)	证券事务代表
王丽娟	赵毅	
办公地址	广州市黄埔区东环路20号	广州市黄埔区东环路20号
电子邮箱	020-82512096	020-82512096
电子邮件	dmb@fndz.com	dmb@fndz.com

2.报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、产品或服务情况

1.主要业务

公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,专注于提供高端电子材料及应用解决方案,现有产品主要是电磁屏蔽膜、各类铜箔、挠性覆铜板、电阻膜层、复合铜箔等。

其中电磁屏蔽膜、标准电子组件(以下简称为“组件”)是公司报告期内的主要收入来源。

2.主要产品与服务情况

(1)电磁屏蔽膜

电磁屏蔽膜是一种厚度在微米级别、具有复杂结构的薄膜,具有抑制电子元件电器元件干扰的功能,通常贴于FPC上使用。现代电子产品“轻量化”和高频高密化趋势更加明显,驱动着电子元件及其组件外部的电磁干扰,以及信号在传输中衰减问题逐渐严重,对电磁屏蔽膜的需求更大,同时也提出了更高的性能要求。

公司的电磁屏蔽膜主要分为HSF-009和HSF-USB3系列。其中HSF-USB3系列是2014年推出的新型电磁屏蔽膜,具备自主研发的独特针孔结构,屏蔽效能进一步提高,同时可大幅降低信号传输损耗,降低信号传输的完整性。公司生产的电磁屏蔽膜产品填补了公司在高端电磁屏蔽领域的空白,打破了国外企业的垄断,目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等终端品牌。

(2)铜箔产品

带载体可剥离铜箔是制备芯片基板、HDI板的必用基材,目前IC载板、类载板的线宽线距已细至10 nm~40 nm,用传统的减成法工艺无法制备,必须使用mSAP(半加成工艺),而mSAP必须使用可剥离铜。公司生产的可剥离铜厚度极薄,电镀铜膜层、载板层及可剥离层之间的剥离力稳定性等参数,同样是HSF-009的制程要求。

电子铜箔是制备IC板(FCCL)、挠性电路板(PCB)、柔性电路板(FPC)的主要材料,主要用于高频率高通量的IC封装铜箔,VIL们主要应用于高频率、低损耗的材料等领域。公司生产的各类电子铜箔,厚度、延伸性、表面粗糙度等指标均满足客户要求。

(3)挠性覆铜板

挠性覆铜板(FCCL)的生产工艺,由挠性铜层与金属箔层合成为产品结构,并实现挠性线路的PCB的连接。根据产品结构,挠性覆铜板可分为分层式双面FCCL和无模双层挠性覆铜板(2L-FCCL);根据铜层厚度,每层包括挠性铜层外侧为普通和极薄型。

下游电子产品的快速发展,推动FPC制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破,从而对FPC的高密互连(HDI)技术要求也不断提高。FCCL是实现高密度互连的关键技术之一,可大幅提升电子元件的可靠性,降低成本并提高可靠性。公司生产的挠性覆铜板产品填补了公司在高端电磁屏蔽领域的空白,打破了国外企业的垄断,目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等终端品牌。

(4)铜箔产品

带载体可剥离铜箔是制备芯片基板、HDI板的必用基材,目前IC载板、类载板的线宽线距已细至10 nm~40 nm,用传统的减成法工艺无法制备,必须使用mSAP(半加成工艺),而mSAP必须使用可剥离铜。公司生产的可剥离铜厚度极薄,电镀铜膜层、载板层及可剥离层之间的剥离力稳定性等参数,同样是HSF-009的制程要求。

电子铜箔是制备IC板(FCCL)、挠性电路板(PCB)、柔性电路板(FPC)的主要材料,主要用于高频率高通量的IC封装铜箔,VIL们主要应用于高频率、低损耗的材料等领域。公司生产的各类电子铜箔,厚度、延伸性、表面粗糙度等指标均满足客户要求。

(5)挠性覆铜板

挠性覆铜板(FCCL)的生产工艺,由挠性铜层与金属箔层合成为产品结构,并实现挠性线路的PCB的连接。根据产品结构,挠性覆铜板可分为分层式双面FCCL和无模双层挠性覆铜板(2L-FCCL);根据铜层厚度,每层包括挠性铜层外侧为普通和极薄型。

下游电子产品的快速发展,推动FPC制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破,从而对FPC的高密互连(HDI)技术要求也不断提高。FCCL是实现高密度互连的关键技术之一,可大幅提升电子元件的可靠性,降低成本并提高可靠性。公司生产的挠性覆铜板产品填补了公司在高端电磁屏蔽领域的空白,打破了国外企业的垄断,目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等终端品牌。

(6)铜箔产品

带载体可剥离铜箔是制备芯片基板、HDI板的必用基材,目前IC载板、类载板的线宽线距已细至10 nm~40 nm,用传统的减成法工艺无法制备,必须使用mSAP(半加成工艺),而mSAP必须使用可剥离铜。公司生产的可剥离铜厚度极薄,电镀铜膜层、载板层及可剥离层之间的剥离力稳定性等参数,同样是HSF-009的制程要求。

(7)挠性覆铜板

挠性覆铜板(FCCL)的生产工艺,由挠性铜层与金属箔层合成为产品结构,并实现挠性线路的PCB的连接。根据产品结构,挠性覆铜板可分为分层式双面FCCL和无模双层挠性覆铜板(2L-FCCL);根据铜层厚度,每层包括挠性铜层外侧为普通和极薄型。

下游电子产品的快速发展,推动FPC制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破,从而对FPC的高密互连(HDI)技术要求也不断提高。FCCL是实现高密度互连的关键技术之一,可大幅提升电子元件的可靠性,降低成本并提高可靠性。公司生产的挠性覆铜板产品填补了公司在高端电磁屏蔽领域的空白,打破了国外企业的垄断,目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等终端品牌。

(8)铜箔产品

带载体可剥离铜箔是制备芯片基板、HDI板的必用基材,目前IC载板、类载板的线宽线距已细至10 nm~40 nm,用传统的减成法工艺无法制备,必须使用mSAP(半加成工艺),而mSAP必须使用可剥离铜。公司生产的可剥离铜厚度极薄,电镀铜膜层、载板层及可剥离层之间的剥离力稳定性等参数,同样是HSF-009的制程要求。

(9)挠性覆铜板

挠性覆铜板(FCCL)的生产工艺,由挠性铜层与金属箔层合成为产品结构,并实现挠性线路的PCB的连接。根据产品结构,挠性覆铜板可分为分层式双面FCCL和无模双层挠性覆铜板(2L-FCCL);根据铜层厚度,每层包括挠性铜层外侧为普通和极薄型。

下游电子产品的快速发展,推动FPC制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破,从而对FPC的高密互连(HDI)技术要求也不断提高。FCCL是实现高密度互连的关键技术之一,可大幅提升电子元件的可靠性,降低成本并提高可靠性。公司生产的挠性覆铜板产品填补了公司在高端电磁屏蔽领域的空白,打破了国外企业的垄断,目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等终端品牌。

(10)铜箔产品

带载体可剥离铜箔是制备芯片基板、HDI板的必用基材,目前IC载板、类载板的线宽线距已细至10 nm~40 nm,用传统的减成法工艺无法制备,必须使用mSAP(半加成工艺),而mSAP必须使用可剥离铜。公司生产的可剥离铜厚度极薄,电镀铜膜层、载板层及可剥离层之间的剥离力稳定性等参数,同样是HSF-009的制程要求。

(11)挠性覆铜板

挠性覆铜板(FCCL)的生产工艺,由挠性铜层与金属箔层合成为产品结构,并实现挠性线路的PCB的连接。根据产品结构,挠性覆铜板可分为分层式双面FCCL和无模双层挠性覆铜板(2L-FCCL);根据铜层厚度,每层包括挠性铜层外侧为普通和极薄型。

下游电子产品的快速发展,推动FPC制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破,从而对FPC的高密互连(HDI)技术要求也不断提高。FCCL是实现高密度互连的关键技术之一,可大幅提升电子元件的可靠性,降低成本并提高可靠性。公司生产的挠性覆铜板产品填补了公司在高端电磁屏蔽领域的空白,打破了国外企业的垄断,目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等终端品牌。

(12)铜箔产品

带载体可剥离铜箔是制备芯片基板、HDI板的必用基材,目前IC载板、类载板的线宽线距已细至10 nm~40 nm,用传统的减成法工艺无法制备,必须使用mSAP(半加成工艺),而mSAP必须使用可剥离铜。公司生产的可剥离铜厚度极薄,电镀铜膜层、载板层及可剥离层之间的剥离力稳定性等参数,同样是HSF-009的制程要求。

(13)挠性覆铜板

挠性覆铜板(FCCL)的生产工艺,由挠性铜层与金属箔层合成为产品结构,并实现挠性线路的PCB的连接。根据产品结构,挠性覆铜板可分为分层式双面FCCL和无模双层挠性覆铜板(2L-FCCL);根据铜层厚度,每层包括挠性铜层外侧为普通和极薄型。

下游电子产品的快速发展,推动FPC制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破,从而对FPC的高密互连(HDI)技术要求也不断提高。FCCL是实现高密度互连的关键技术之一,可大幅提升电子元件的可靠性,降低成本并提高可靠性。公司生产的挠性覆铜板产品填补了公司在高端电磁屏蔽领域的空白,打破了国外企业的垄断,目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等终端品牌。

(14)铜箔产品

带载体可剥离铜箔是制备芯片基板、HDI板的必用基材,目前IC载板、类载板的线宽线距已细至10 nm~40 nm,用传统的减成法工艺无法制备,必须使用mSAP(半加成工艺),而mSAP必须使用可剥离铜。公司生产的可剥离铜厚度极薄,电镀铜膜层、载板层及可剥离层之间的剥离力稳定性等参数,同样是HSF-009的制程要求。

(15)挠性覆铜板

挠性覆铜板(FCCL)的生产工艺,由挠性铜层与金属箔层合成为产品结构,并实现挠性线路的PCB的连接。根据产品结构,挠性覆铜板可分为分层式双面FCCL和无模双层挠性覆铜板(2L-FCCL);根据铜层厚度,每层包括挠性铜层外侧为普通和极薄型。

下游电子产品的快速发展,推动FPC制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破,从而对FPC的高密互连(HDI)技术要求也不断提高。FCCL是实现高密度互连的关键技术之一,可大幅提升电子元件的可靠性,降低成本并提高可靠性。公司生产的挠性覆铜板产品填补了公司在高端电磁屏蔽领域的空白,打破了国外企业的垄断,目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等终端品牌。

(16)铜箔产品

带载体可剥离铜箔是制备芯片基板、HDI板的必用基材,目前IC载板、类载板的线宽线距已细至10 nm~40 nm,用传统的减成法工艺无法制备,必须使用mSAP(半加成工艺),而mSAP必须使用可剥离铜。公司生产的可剥离铜厚度极薄,电镀铜膜层、载板层及可剥离层之间的剥离力稳定性等参数,同样是HSF-009的制程要求。

(17)挠性覆铜板

挠性覆铜板(FCCL)的生产工艺,由挠性铜层与金属箔层合成为产品结构,并实现挠性线路的PCB的连接。根据产品结构,挠性覆铜板可分为分层式双面FCCL和无模双层挠性覆铜板(2L-FCCL);根据铜层厚度,每层包括挠性铜层外侧为普通和极薄型。

下游电子产品的快速发展,推动FPC制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破,从而对FPC的高密互连(HDI)技术要求也不断提高。FCCL是实现高密度互连的关键技术之一,可大幅提升电子元件的可靠性,降低成本并提高可靠性。公司生产的挠性覆铜板产品填补了公司在高端电磁屏蔽领域的空白,打破了国外企业的垄断,目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等终端品牌。

(18)铜箔产品

带载体可剥离铜箔是制备芯片基板、HDI板的必用基材,目前IC载板、类载板的线宽线距已细至10 nm~40 nm,用传统的减成法工艺无法制备,必须使用mSAP(半加成工艺),而mSAP必须使用可剥离铜。公司生产的可剥离铜厚度极薄,电镀铜膜层、载板层及可剥离层之间的剥离力稳定性等参数,同样是HSF-009的制程要求。

(19)挠性覆铜板

挠性覆铜板(FCCL)的生产工艺,由挠性铜层与金属箔层合成为产品结构,并实现挠性线路的PCB的连接。根据产品结构,挠性覆铜板可分为分层式双面FCCL和无模双层挠性覆铜板(2L-FCCL);根据铜层厚度,每层包括挠性铜层外侧为普通和极薄型。

下游电子产品的快速发展,推动FPC制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破,从而对FPC的高密互连(HDI)技术要求也不断提高。FCCL是实现高密度互连的关键技术之一,可大幅提升电子元件的可靠性,降低成本并提高可靠性。公司生产的挠性覆铜板产品填补了公司在高端电磁屏蔽领域的空白,打破了国外企业的垄断,目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等终端品牌。

(20)公司产品

带载体可剥离铜箔是制备芯片基板、HDI板的必用基材,目前IC载板、类载板的线宽线距已细至10 nm~40 nm,用传统的减成法工艺无法制备,必须使用mSAP(半加成工艺),而mSAP必须使用可剥离铜。公司生产的可剥离铜厚度极薄,电镀铜膜层、载板层及可剥离层之间的剥离力稳定性等参数,同样是HSF-009的制程要求。

(21)挠性覆铜板

挠性覆铜板(FCCL)的生产工艺,由挠性铜层与金属箔层合成为产品结构,并实现挠性线路的PCB的连接。根据产品结构,挠性覆铜板可分为分层式双面FCCL和无模双层挠性覆铜板(2L-FCCL);根据铜层厚度,每层包括挠性铜层外侧为普通和极薄型。

下游电子产品的快速发展,推动FPC制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破,从而对FPC的高密互连(HDI)技术要求也不断提高。FCCL是实现高密度互连的关键技术之一,可大幅提升电子元件的可靠性,降低成本并提高可靠性。公司生产的挠性覆铜板产品填补了公司在高端电磁屏蔽领域的空白,打破了国外企业的垄断,目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等终端品牌。

(22)公司产品

带载体可剥离铜箔是制备芯片基板、HDI板的必用基材,目前IC载板、类载板的线宽线距已细至10 nm~40 nm,用传统的减成法工艺无法制备,必须使用mSAP(半加成工艺),而mSAP必须使用可剥离铜。公司生产的可剥离铜厚度极薄,电镀铜膜层、载板层及可剥离层之间的剥离力稳定性等参数,同样是HSF-009的制程要求。

(23)挠性覆铜板

挠性覆铜板(FCCL)的生产工艺,由挠性铜层与金属箔层合成为产品结构,并实现挠性线路的PCB的连接。根据产品结构,挠性覆铜板可分为分层式双面FCCL和无模双